

PacTech präsentiert Solder Jetting Plattform der neuen Generation „SB²-SMs Quantum“

Die neue SB²-SMs Quantum erweitert das Produktportfolio des in Nauen bei Berlin ansässigen Unternehmens.

Die neue Generation des PacTech Verkaufsschlagers wird den Markt erobern, dessen Ansprüche ständig wachsen und der sich immer wieder im Wandel befindet. PacTech begegnet damit dem Trend des komplexen 3D-Lötprozesses von Kameramodulen für Smartphones. Auch für das Bearbeiten von mikrooptischen Linsen oder für das Verlöten von feinsten Drähten z.B. in Schwing-Spulenmotoren wurde dieser Maschinentyp konzipiert.

Die neue SB²-SMs Quantum besticht durch einen hohen Durchsatz und große Prozessstabilität. Sie ist im Gegensatz zu Ihrem Vorgängermodell kompakter und damit platzsparender. Es können Lotkugeln mit einem Durchmesser von 250µm bis 760µm in den verschiedensten Legierungen platziert werden. Wobei PacTech auf Wunsch auch wesentlich kleinere Lotkugeln mit einem Durchmesser von bis zu 40µm aufbringen kann, dann jedoch mit einem anderen Modell der Solder Jetting Plattform.

Die neue SB²-SMs verfügt über ein wesentlich größeres Ladevolumen. Außerdem konnte die gesamte Prozessführung durch die Einführung einer zum Bonding Prozess parallel statt findenden Kamerainspektion optimiert werden. Durch diese beiden Neuerungen wurde der Durchsatz signifikant gesteigert.

Ein komplexer produktspezifischer Werkstückträger (Tooling) mit automatischer Dreh – und Kippfunktion ermöglicht das Prozessieren von Bauteilen mit Lötstellen auf unterschiedlichen Bauteilseiten.

Außerdem bringt PacTech Farbe ins Spiel. Die Maschine kann optional mit einem rot-schwarzen Antistatik Lack veredelt werden.

Als Sondermaschinenhersteller kann PacTech äußerst flexibel auf Kundenwünsche und -anforderungen eingehen. Das Unternehmen akquiriert seine Kunden vorrangig aus den Bereichen der Consumer Electronics, Telekommunikation, Automotive und Medizintechnik.

